

第2回WBG実装コンソーシアム 「パワーモジュールの動向及び接合技術」



2022年9月8日（木） Zoomウェビナーによるオンライン開催

【第1部】講演会

- 13:30～13:35 開会挨拶 大阪大学 F3D実装協働研究所 所長 菅沼 克昭
- 13:35～14:20 「先進パワー半導体のモジュール化技術」
産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 山口 浩 氏
- 14:20～14:30 一休憩一
- 14:30～15:15 「GaN-HEMTの高出力化に向けたダイヤモンド放熱技術」
富士通株式会社 研究本部 デバイス&マテリアル研究センター 山田 敦史 氏
- 15:15～16:00 「高信頼の銀焼結接合構造の設計と新型銅-銀複合実装材料の開発」
大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 陳 伝トウ

【第2部】「パワー半導体モジュールに関する課題整理とその取り組み」に向けての検討

- 16:15～17:30 会員企業(委員)プレゼン:会社紹介及びパワー半導体モジュールに関しての意見(20分/社)
- ①株式会社クレハ(工藤様)
 - ②住友金属鉱山株式会社(植田様)
 - ③上村工業株式会社(小田様)